

证券代码：301629

证券简称：矽电股份

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司

2026 年 7 月投资者关系活动记录表

编号：2026-002

|                    |                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资者关系<br>活动类别      | <div><div><div>■ 特定对象调研</div><div>□ 媒体采访</div><div>□ 新闻发布会</div><div>■ 现场参观</div><div>□ 其他 （请文字说明其他活动内容）</div></div><div><div>□ 分析师会议</div><div>□ 业绩说明会</div><div>□ 路演活动</div></div></div>                                                    |
| 参与单位名称             | <div>（时间先后顺序排列）</div> <div>华泰证券、人保资产、中信证券、方正证券、平安基金、中航证券、浙商证券、华夏基金、中邮证券、信达澳亚基金、长城基金、国联民生证券、中银基金、前海开源基金、鹏华基金、摩根士丹利、汇添富基金、东方证券、万家基金</div>                                                                                                       |
| 时间                 | 2026 年 7 月 1 日至 2026 年 7 月 29 日                                                                                                                                                                                                               |
| 地点                 | 公司会议室、深圳香格里拉酒店、腾讯会议                                                                                                                                                                                                                           |
| 上市公司<br>接待人员<br>姓名 | <div>副总经理兼董事会秘书：杨波先生</div> <div>证券事务代表：陈裕强先生</div>                                                                                                                                                                                            |
| 投资者关系<br>活动主要内容介绍  | <div>一、公司基本情况介绍</div> <div>矽电半导体设备（深圳）股份有限公司成立于 2003 年，二十多年来持续专注于半导体探针台的研发、生产和销售。是目前境内规模最大、技术领先、品类齐全的国产探针台制造企业，也是中国大陆首家实现产业化应用的 12 英寸晶圆探针台设备国产厂商，已在多个半导体产品领域打破海外厂商垄断，产品已广泛应用于集成电路、分立器件、光电芯片、第三代化合物半导体等半导体产品制造领域及封测领域。</div> <div>二、问答交流</div> |

### **（一）公司有哪些产品？未来新品计划**

公司目前针对不同应用领域及芯片尺寸共推出了 6 大系列共 30 多款产品，打造了完备的产品矩阵。主导产品晶圆探针台和晶粒探针台共有 20 多款，能够满足不同领域的探针测试需求，其中 12 吋高端晶圆探针台已推出两代机型，能够在集成电路领域实现对进口高端机型的国产替代；其次，公司近年来相继推出了晶粒分选机、AOI 检测设备、固晶机等系列设备，不断丰富公司的产品线。公司未来将继续聚焦半导体测试设备领域，持续加大研发投入，不断提升技术成果转化能力及综合配套能力。

### **（二）公司在集成电路领域的开拓进展**

公司正加快推进集成电路领域的晶圆探针台导入验证工作，扩大在集成电路晶圆制造、晶圆级封装测试等应用领域的项目覆盖面。2025 年至今公司已进入多家国内集成电路主要厂商开展试机验证，目前试机验证环节在有序推进之中。由于高端晶圆探针台市场的定制化需求和验证要求高等特点，验证周期较长，公司争取加快推进项目进展，为后续承接相关订单打下基础。

### **（三）如何看待 LED 领域的扩产趋势？**

2025 年至今年一季度，公司在 LED 领域的部分主要客户因阶段性的产能消化和技术路线选型，对公司的测试设备新增采购需求有所减少，但这是阶段性的表现，公司聚焦的 LED 先进显示领域市场需求持续增长的长期逻辑没有改变。目前公司已公告与兆驰股份签订的大额订单合同，后续 LED 将有更多主要厂商进入设备采购阶段，公司争取承接更多订单。

### **（三）公司在光通信芯片领域的业务布局**

光通信芯片测试是公司产品应用领域之一，公司目前销售适用于 PD/APD/VCSEL 等芯片测试的探针测试一体机、分选机、AOI 等设备，适用于硅光晶圆测试的 12 吋全自动高精度晶圆探针台设备，具体产品信息请查看公司公告或官网。公司看好该领域长期发展前景，将持续通过优化设计，合理安排生产计划，持续推进技术储备与客户验证，以保

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <p>持竞争优势。</p> <p><b>（四）目前公司在手订单情况，订单景气度如何？</b></p> <p>今年以来，公司主要在售产品的市场需求旺盛，景气度持续上升，公司积极抢抓订单，目前在手订单较为充足，产能利用率持续处于较高水平，生产计划安排紧凑，产线排产周期拉长，产线满负荷运转。充足的在手订单将对公司未来经营业绩形成积极支撑，但最终业绩实现受交付、验收进度等多方面因素影响，存在不确定性。</p> <p><b>（五）公司目前产能利用率及扩产情况</b></p> <p>目前公司在手订单较为充足，产能利用率达到满产状态。公司首次公开发行股票募集资金正按计划用于探针台研发及产业基地建设、分选机技术研发、营销网络建设等项目。今年以来，为确保在手订单顺利交付，公司加快产能扩张速度以应对下游客户需求的持续增长，新增产能已按规划分阶段投产，产能规模持续提升。未来公司将根据募投项目进展及市场需求情况，合理规划产能安排。</p> <p><b>（六）公司未来业务发展方向</b></p> <p>未来公司将继续聚焦探针台领域，一是夯实公司在光电芯片领域的基本盘，二是不断扩大在分立器件/功率半导体/模拟芯片/第三代半导体领域的市场份额，三是积极把握硅光晶圆测试、光通信芯片测试的市场机遇，四是在现有客户中同步导入更多延伸机型，五是集中资源，全力推进集成电路头部厂商的试机验证，六是积极推进海外市场业务开拓。</p> |
| 关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明 | 活动不涉及应披露的重大信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 附件清单<br>(如有)         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

---

|    |                |
|----|----------------|
| 日期 | 2026 年 8 月 4 日 |
|----|----------------|